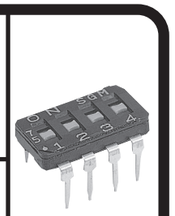
DIP シリーズ Series

品名　超薄形ディップスイッチ LDS7

Part No.　Ultra-Low Profile DIP Switches

端子部形状　Terminal Style
P/Cタイプ
PC



仕様　Specifications

定格	最大定格　DC50V　100mA 最小定格　DC20mV　1μA	Rating	100mA　50V DC　Max. 1μA　20mV DC　Min.
初期接触抵抗	50mΩ以下(AC200μV　1.5mA)	Initial Contact Resistance	50mΩ Max.(1.5mA　200μV AC)
初期耐電圧	AC500V　1分間	Initial Dielectric Strength	500V AC　1minute
初期絶縁抵抗	1,000MΩ以上(DC100V)	Initial Insulation Resistance	1,000MΩ Min.(100V DC)
電気的寿命	1,000回	Electrical Life	1,000 Cycles.
動作力	0.49～5.88N(0.05～0.6kgf)	Operating Force	0.49～5.88N(0.05～0.6kgf)
使用温度範囲	−25～+80℃	Operating Temperature Range	−25～+80℃
保存温度範囲	−40～+80℃	Storage Temperature Range	−40～+80℃

品名の説明　Part Numbering

LDS　7　10

- LDS：シリーズ記号 Series Code
- 7：構造 Structure
- 10：極数 Number of Poles

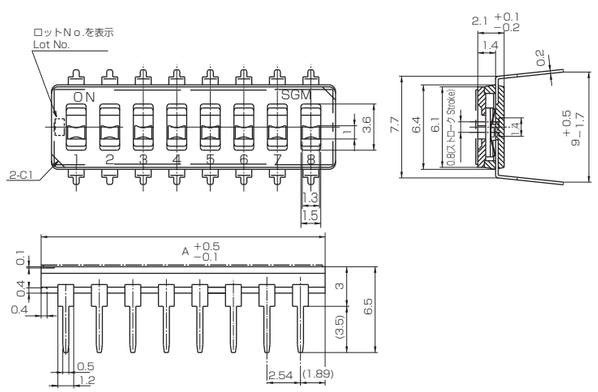
LDS	PCタイプ PC Type

7	テープシールタイプ Tape Seal Type
8	スタンダードタイプ Standard Type

02	2極 2 Pole
04	4極 4 Pole
06	6極 6 Pole
08	8極 8 Pole
10	10極 10 Pole

LDS7　テープシールタイプ Tape Seal Type

品名 Part No.	回路図 Circuit	極数 Number of Poles	A寸法 DimensionA
LDS702	1 2	2	6.30
LDS704	1 2 3 4	4	11.40
LDS706	1 2 3 4 5 6	6	16.45
LDS708	1 2 3 4 5 6 7 8	8	21.55
LDS710	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	10	26.60



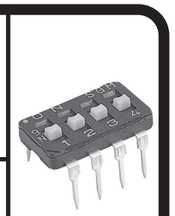
SGM

DIP シリーズ Series

品名　超薄形ディップスイッチ LDS8

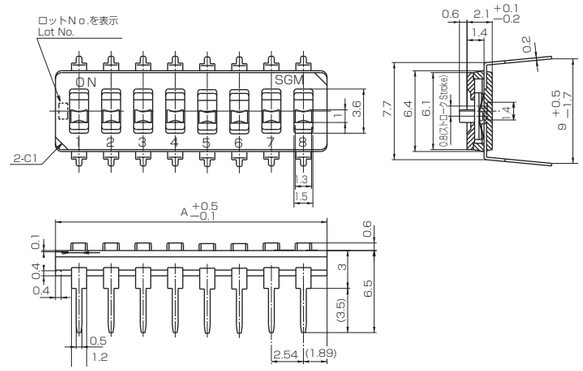
Part No.　Ultra-Low Profile DIP Switches

端子部形状　Terminal Style
P/Cタイプ
PC



LDS8　スタンダードタイプ Standard Type

品名 Part No.	回路図 Circuit	極数 Number of Poles	A寸法 DimensionA
LDS802	1 2	2	6.30
LDS804	1 2 3 4	4	11.40
LDS806	1 2 3 4 5 6	6	16.45
LDS808	1 2 3 4 5 6 7 8	8	21.55
LDS810	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	10	26.60



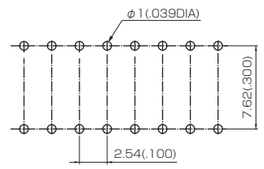
超薄形ディップスイッチ

1.はんだ付け仕様/Soldering Requirements

(1)手付け/Hand Soldering
①コテ先温度350℃以下　3秒以内。　350℃ 3 sec, max.
②コテ先温度270℃以下　5秒以内。　270℃ 5 sec, max.

(2)フローライン/Auto Soldering
装置：噴流式または浸漬式260℃　5秒以内
Device:jet wave or dip type 260℃ 5sec, max.

プリント基板取付ラウンド寸法(参考)
PC Hole Layout



2.洗浄仕様/Cleaning

(1)はんだ付け後はスイッチの温度が70℃以下になってから洗浄してください。
Be sure to do the cleaning when switch temperature drops to 70℃ or lower.

(2)丸洗い洗浄(浸漬洗浄)は液温が50℃以下で洗浄してください。
Immersion cleaning (dipped cleaning) should be done when solution temperature is 50℃ or lower.

3.スイッチ操作およびテープ貼り付けについて/ Operating Actuators and Tape Sealing

(1)操作はピンセット、ボールペン等で行ってください。
Use tweezers or ball-point pens to operate actuators.

(2)ツマミに2kgf以上の力(図の矢印方向)を加えないでください。ツマミが変形し接触不良の原因になります。
Don't apply an excessive force of 2kgf or more to the arrow-marked directions of actuators.
Otherwise, the actuators might be deformed, causing contact failures.

(3)テープを剥がして再度貼り付けると、粘着力が弱くなりフラックスの流入の原因になります。
Once tape removed, don't re-seal it. Otherwise flux may flow into the switch enclosure due to the weakened adhesive, causing contact failure.

4.包装仕様/Packaging Information/Ordering

(1)スティック仕様（スティック1本当りの個数）
Stick Packaging (Quantity/Stick)

品名 Part No.	極数 Pole	2	4	6	8	10
LDS7 LDS8	数量 Q'ty	72	40	28	20	16

SGM